

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2023 年-2025 年发生的关联交易事项进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年-2025 年期间内关联交易事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 本公司的共同控股股东情况

杭州大和热磁电子有限公司（以下简称“杭州热磁”）和上海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）均系日本磁性技术公司（以下简称“日本磁性技术”）全资子公司，其中杭州热磁直接持有公司 15.1209% 股份，上海申和直接持有公司 8.3085% 股份。杭州热磁和上海申和与公司持股平台宁波富乐国企业管理

合伙企业（有限合伙）、宁波富乐德企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐华企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐中企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐强企业管理合伙企业（有限合伙）签署了一致行动协议，前述持股平台持有公司 4.86% 的股份，杭州热磁与上海申和合计控制公司 28.29% 的表决权，为公司共同控股股东。

日本磁性技术不存在单一股东持股比例超过 30% 的情况，不存在单一股东单独控制董事会的情形，不存在单一股东对公司决策构成实质性影响。故本公司无实际控制人。

2. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
贺贤汉	董事长
日本磁性技术公司	上海申和公司之母公司
安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司	上海申和公司之子公司
安徽富乐德科技发展股份有限公司	
上海汉虹精密机械有限公司	
上海富乐德智能科技发展有限公司	
Ferrotec Nord Corporation	日本磁性技术公司之子公司
Ferrotec Taiwan Co., Ltd	
香港第一半导体科技股份有限公司 (First Semiconductor Technology Holding Co., Ltd.)	
杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	杭州大和热磁电子有限公司之子公司
宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司	
浙江富乐德石英科技有限公司	
江苏富乐德石英科技有限公司	
丽水常禾餐饮管理有限公司	
博芯微（上海）半导体科技有限公司	董事长贺贤汉控制之公司
上海富乐华半导体科技有限公司	上海申和公司之孙公司
中微半导体设备（上海）股份有限公司	公司前董事杜志游担任前董事的

	企业
中微半导体（上海）有限公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司之子公司
中微半导体设备（四川）有限公司	

三、定价情况

（一）定价依据

公司各项日常关联交易以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

公司各项日常关联交易是基于商业交易条件基础上自愿达成，以市场价格为依据，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，交易定价具备公允性，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	交易内容	2025 年	2024 年	2023 年
上海申和	物业费	194,701.08	195,395.40	87,058.44
宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司	采购材料、加工费	80,814,992.37	47,628,463.69	33,243,954.87
浙江富乐德石英科技有限公司	采购材料、修理费	3,125,794.14	3,091,276.32	3,269,070.48
杭州热磁	采购材料、修理费、维保费	3,400.00	2,810,831.86	9,912,000.00
江苏富乐德石英科技有限公司	采购材料	1,358,596.44	1,485,669.91	
杭州盾源聚芯半导体	采购材料	110,340.00	626,000.00	1,661,965.49

科技有限公司				
上海富乐德智能科技发展有限公司	测试服务、 电费	317,754.42	1,521,444.00	
安徽富乐德科技发展有限公司	修理费	194,442.63	511,382.50	46,500.00
Ferrotec NORD Corporation	销售服务费	349,161.25		
合计		86,469,182.33	57,870,463.68	48,220,549.28

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	交易内容	2025年	2024年	2023年
上海富乐华半导体科技有限公司	销售液氮、检测费	3,965,508.00	4,573,680.00	1,945,782.24
安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司	硅片	1,412,787.61		
Ferrotec NORD Corporation	硅片			5,348,975.22
上海富乐德智能科技发展有限公司	废水处理服务、检测费	393,627.38	1,312,423.50	
上海申和	销售液氮、纯水加工服务	32,977.99	556,092.19	1,326,783.74
安徽富乐德科技发展有限公司	销售备品备件、检测费	3,647.71	55,236.79	
杭州热磁	其他		136,262.26	113,343.40
中微半导体设备（上海）股份有限公司	测试费	207,075.47	208,962.26	305,660.37
中微半导体（上海）有限公司	硅片	2,265,300.00		
中微半导体设备（四川）有限公司	硅片	149,400.00		

合 计		8,430,324.16	6,842,657.00	9,040,544.97
-----	--	--------------	--------------	--------------

2. 关联租赁情况

(1) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产 种类	2025 年			
		简化处理的短期租赁 和低价值资产租赁的 租金费用以及未纳入 租赁负债计量的可变 租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括 未纳入租赁负债计量 的可变租赁付款额）	增加的租赁 负债本金金 额	确认的利息 支出
上海申和	厂房租金		8,223,510.36		796,386.18
上海汉虹精密 机械有限公司	宿舍租金	1,107,000.00			
小 计		1,107,000.00	8,223,510.36		796,386.18

出租方名称	租赁资产 种类	2024 年			
		简化处理的短期租赁 和低价值资产租赁的 租金费用以及未纳入 租赁负债计量的可变 租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括 未纳入租赁负债计量 的可变租赁付款额）	增加的租赁 负债本金金 额	确认的利息 支出
上海申和	厂房租金		8,140,087.19		937,596.34
上海汉虹精密 机械有限公司	宿舍租金	1,047,000.00			
小 计		1,047,000.00	8,140,087.19		937,596.34

出租方名称	租赁资产 种类	2023 年			
		简化处理的短期租赁 和低价值资产租赁的 租金费用以及未纳入	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括 未纳入租赁负债计量	增加的租赁 负债本金金	确认的利息 支出

		租赁负债计量的可变 租赁付款额	的可变租赁付款额)	额	
上海申和	厂房租金		6,897,993.60		819,755.75
上海汉虹精密 机械有限公司	宿舍租金	445,500.00			
小 计		445,500.00	6,897,993.60		819,755.75

3. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
杭州热磁	100,000,000.00	2025/12/5	2026/12/5	否
杭州热磁	130,000,000.00	2024/12/31	2025/12/30	是

(2) 其他

日本磁性技术公司还为公司全资子公司日本中欣的房屋租赁提供担保，日本中欣作为被担保方，对公司持续经营能力不构成重大障碍。

4. 关联方资金拆入/拆出

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州热磁[注]	24,000,000.00	2025/8/4	2025/9/30	

[注] 本期杭州大和热磁电子有限公司向公司支付 74,000,000.00 元增资保证金，截至 2025 年 12 月 31 日公司已结清

5. 关键管理人员报酬

项 目	2025 年	2024 年	2023 年
关键管理人员报酬	6,383,745.46	4,950,816.02	5,092,177.82

6. 其他关联交易

关联方	交易内容	2025 年	2024 年	2023 年
上海汉虹精密机械 有限公司	采购设备及 配件	121,976,258.24	94,724,119.34	8,730,642.56

香港第一半导体科技股份有限公司	采购设备	192,630,000.00	264,538,760.00	
杭州热磁	采购设备	1,778,000.00		
博芯微（上海）半导体科技有限公司	采购设备	616,963.81		
丽水常禾餐饮管理有限公司	销售设备		1,882,031.86	
上海申和	代垫水电费	34,695,015.96	35,353,718.51	35,235,569.04
小 计		351,696,238.01	396,498,629.71	43,966,211.60

（二）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2025 年		2024 年		2023 年	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款							
	Ferrotec Nord Corporation			3,112,363.68	926,959.23	3,084,332.04	132,153.97
	安徽富乐德科技发展股份有限公司	62,417.57	6,241.76	55,236.79	1,657.10		
	上海富乐德智能科技发展有限公司	383,325.48	11,499.76	1,312,423.50	39,372.71		
	上海申和	34,956.69	2,250.14	119,769.06	3,593.07		
	上海富乐华半导体科技有限公司	724,963.68	21,748.91				
	安徽富乐德长江半导体材料股份	1,044,000.00	31,320.00				

	有限公司						
小计		2,249,663.42	73,060.57	4,599,793.03	971,582.11	3,084,332.04	132,153.97
其他非流动资产							
	上海汉虹精密机械有限公司			61,107,273.93		40,418,533.42	
	香港第一半导体科技股份有限公司			105,557,400.00		70,761,896.40	
小计				166,664,673.93		111,180,429.82	
其他应收款							
	丽水常禾餐饮管理有限公司			2,150,575.71	64,517.27		
小计				2,150,575.71	64,517.27		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2025年	2024年	2023年
应付账款				
	香港第一半导体科技股份有限公司	107,408,990.00	70,005,590.00	7,504,320.00
	上海汉虹精密机械有限公司	54,087,635.43	35,420,721.02	9,223,851.71

	宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司	66,469,032.41	20,921,886.00	5,975,718.00
	上海申和	18,977,444.28	9,733,521.55	2,708,201.63
	杭州热磁	9,477,302.00	7,475,620.00	8,617,380.00
	浙江富乐德石英科技有限公司	7,118,689.58	4,505,565.28	3,667,582.60
	江苏富乐德石英科技有限公司	1,603,947.33	1,678,807.00	
	上海富乐德智能科技发展有限公司	336,819.79	1,521,444.00	
	安徽富乐德科技发展股份有限公司	627,006.59	523,484.10	52,545.00
	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	54,045.00	474,600.00	283,630.00
	Ferrotec Taiwan Co., Ltd	30,508.02	31,099.59	
	博芯微（上海）半导体科技有限公司	69,716.91		
小 计		266,261,137.34	152,292,338.54	38,033,228.94
应付票据				
	宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司		10,541,699.65	
	上海汉虹精密机械有限公司		390,045.29	
小 计			10,931,744.94	

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的，必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易基于商业交易条件基础上自愿达成，以市场价格为依据，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，交易定价具备公允性，不存在损害公司或股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
董事会

2026年3月24日